

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他（腾讯会议、券商策略会）
参与单位名称	华福证券、勤辰投资、中银三星人寿、姚泾河私募基金、浙商证券、中信证券、海富通基金、中泰证券、鑫元基金、万家基金、华夏基金、广发证券、富国基金、上银基金、Optimas Capital、新华资产、德邦基金、东吴基金、Citadel、汇丰晋信基金、南土资产、建信养老金、财信基金、混沌投资、建信基金、交银施罗德基金、银河基金、汇添富基金、中银基金、泰康资产、南方基金、国联民生证券、太平基金、长江证券、广发基金、景顺长城基金、平安资管、领益资产、嘉实基金、中邮资管、君龙人寿、安联保险资管、友邦保险资管、海港人寿、比亚迪财险、兴业证券、民生通惠资产、光大证券等 89 家次机构投资者
时间	2026 年 8 月 19 日—2026 年 9 月 22 日
地点	公司会议室、上海
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 刘艺 IR 经理 郭越
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 1、OCS市场未来发展空间如何？公司目前在不同OCS技术路线下有哪些产品布局和业务进展？ OCS是AI算力集群光互联架构持续演进的重要技术方向之一，通过光路切换实现网络拓扑的灵活重构。从行业公开信息看，随着全球头部云厂商持续推进大规模AI算力集群建设，OCS在不同AI算力平台中的应用探索持续推进，将进一步拓展相关精密光学元器件的应用空间。根据行业研究机构Cignal AI在2026年7月的预测，全球OCS市场到2030年将超过80亿美元。 公司作为上游光电子元器件供应商，产品适配MEMS、液晶、压电陶瓷等多元OCS技术路径，根据国内外主要OCS整机厂商的技术方案，可提供包含准直器、二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4钽酸钪晶体、透镜、棱镜、反射镜在内的多款精密光学元器件产品。公司在液晶方案的部分产品已批量生产，MEMS、压电陶瓷方案的相关元器件产品计划在年内实现量产。 2、公司在CPO领域的产品布局，公司在硅透镜方面的产品情况，公司产品、技术是否可以复用于NPO领域，相关产品产能如何规划？

公司在CPO领域开发验证的产品主要有：

①用于连接CPO光引擎的FAU光连接组件；

②用于ELS外置光源模块中CW激光器与保偏光纤耦合用的柱面、非球柱面、自由曲面等一体化透镜；

硅透镜可以满足多通道、高密度、低损耗的耦合要求，公司已构建微纳光学技术平台，该产品目前处于验证阶段。公司在精密光学冷加工、超精密玻璃模压及微纳光学加工方面的技术布局，可适配不同客户、不同技术方案对于玻璃透镜、硅透镜的多元化需求。不同材料在光学性能、加工工艺、成本及应用场景等方面各具特点，具体选型取决于客户光学设计和系统指标。

NPO是行业正在推进的高速光互联方案之一，在无源光学元组件供给、产业链配套层面与传统可插拔光模块具备一定的协同性。公司的核心技术具有较强的平台化复用属性，已形成适配多元光通信技术路线的精密光学能力。

3、合肥、泰国、郑州工厂进展情况如何，公司如何保障新增产能有效释放和产品质量，在国际贸易环境多变的背景下如何保障海外客户交付？

目前合肥工厂钷酸钕晶体项目已完成一期和二期扩产，产线满负荷生产；泰国工厂已完成建设并持续推进投产工作；郑州工厂按计划推进项目建设，部分产线已逐步投入使用，进入量产起步阶段。

公司将根据客户验证及订单需求，分阶段推进新增产线投产，持续加强工艺标准化、质量管理和人员培训。新增产线从设备调试、试生产到稳定量产需要一定爬坡过程，实际产能释放节奏受产品验证、良率、产品结构及客户动态需求变化等因素影响。

公司将结合客户需求完善境内外产能及供应链布局，以持续提升交付的灵活性和供应链韧性。

4、控股子公司GouMax与高迈光通讯目前如何协同，在手订单及交付情况如何，未来光测试仪器业务将重点从哪些方向推进？

随着AI算力驱动光通信产业研发、扩产及产线建设投入增加，带动光测试仪器需求增长；同时，高速光模块持续向更高速率演进，硅光、CPO、OCS等相关技术和应用的持续发展，对测试精度、效率及自动化能力提出更高要求，并催生新的测试需求。

公司持续推进控股子公司GouMax与高迈光通讯在光测试仪器产品的研发、生产及境内外市场的协同。GouMax发挥技术和海外优势，高迈光通讯重点加强境内量产能力和订单交付。目前公司在手订单饱满，境内生产端运行顺畅，随着产能释放，预计今年整体交付能力较上年有较大提升。

5、公司半导体设备领域光学业务目前进展如何，未来业务发展及产能如何规划？

公司持续聚焦半导体设备领域高端光学模组及相关精

	密光学元组件产品，推进产品设计、生产与测试关键工艺攻关，加强工程技术力量投入和交付能力提升，相关业务规模持续增长，已成为光通信业务之外的重要增长来源。 未来，公司将把握半导体设备国产化发展机遇，持续推进高附加值光学元器件和模组产品的研发及产业化，并结合客户验证、订单需求及产品交付进展，不断扩充产能，提升规模化、稳定化交付能力。
附件清单(如有)	风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、经营目标等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及应披露的重大信息。